

銀燦推出高整合 IS917 晶片

2013-09-04 04:10 工商時報 王奕勛

隨著 USB 3.0 成為 IT 裝置主流介面，市調機構預估市場規模將會有大幅成長率，同時 NAND Flash 記憶體單位成本不斷下降，以及高效能容量需求的擴充，如何使用目前最具備單位容量成本競爭力的 NAND 記憶體，同時發揮 USB 3.0 高速傳輸的效益因應市場需求，已成為頂尖業者必達的目標。

銀燦科技目前於全球 USB 3.0 市佔率高居第一，總經理詹政鋒表示，2012 年領先推出單通道控制晶片 IS916EN，支援新製程 21nm/19nm TLC 型的 NAND Flash，使 USB 3.0 隨身碟總成本更接近 USB 2.0，加快 U3/U2 市場轉換的速度，2013 年第 3 季將更進一步推出內建晶振電元的高整合晶片「IS917」；他強調，IS917 除了有更高的整合度，能減少外部關鍵零件、有效降低客戶成本外，同時也具備更高效能，IS917 已獲得國內外多家知名大廠的新開案合作，預計 9 月正式量產，對該公司第 4 季業績相對有顯著提升。

銀燦副總李政逸補充說，該公司專注於儲存控制 IC 開發，於成立 1 年內便完成 0.18um 32 位元 CPU SSD/UFD 控制 IC 開發，並依循關鍵零組件控制 IC 產品發展技術藍圖，搭配相關的技術資源，藉由團隊高科技研究發展與策略聯盟合作建立完整產品線，進而開發出高效能、低耗電產品。網址：www.innostor.com。